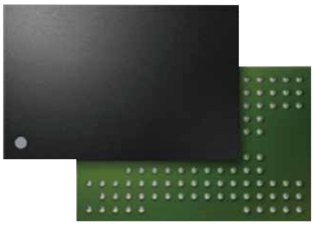
Technical RoadMap

Contents		Technology Roadmap（Unit: μm）		
		FY2025	FY2026	FY2027
L/S Line Width/Space	Tenting（Cu thickness 13μm）	25/30	←	←
	MSAP（Cu thickness 13μm）	20/20	15/20	15/15
WB Pad Width/Space	Tenting（Cu thickness 13μm）	70	←	←
	MSAP（Cu thickness 13μm）	55	50	←
Laser Via Pitch/via Size/Pad Diameter（Annular Ring）		160/60/120	140/50/100	120/40/80
Mechanical Via Size/Pad Diameter（Annular Ring）		100/200（50）	80/180（50）	←
Core Thickness		40	←	←
PP Thickness		20	15	←
Copper thickness		13	10	←
Coreless	Availability	○	←	←
Solder Resist	Thickness	13	←	←
	SRO Size	100	80	←
	SRR	20	15	←
	Flatness	5	←	←
	Method	Ink/DFSR	←	←
Surface Finish	Au Plating	Soft/Hard/ENEPIG	←	←
	OSP	Shikoku: F2LX（PK）	←	←
Front and back misalignment		25	20	←
Total Thickness		Cored（2L）90 Coreless（3L）106	Cored（2L）85 Coreless（3L）85	←
Strip Size（Small Strip）		Min 25mm	←	←
Process		STD/EB/EBS	←	←

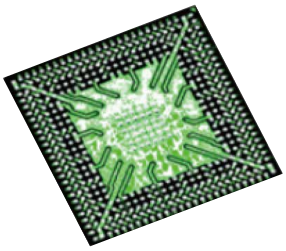
製品紹介

メモリーカード

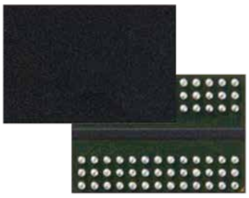
NANDフラッシュメモリー



PBGA



DDR



MEIKO